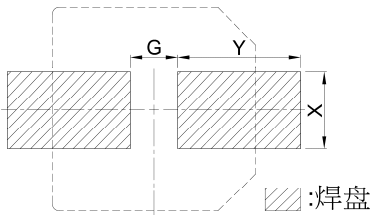


贴片型回流焊接条件

● 焊盘型式与适用制品尺寸

单位：毫米

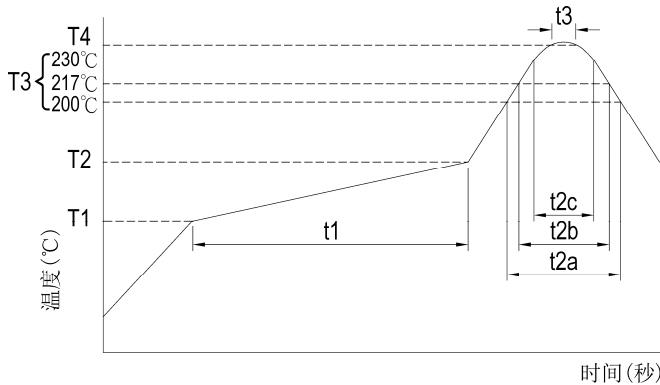


制品尺寸 Dφ×L	焊盘尺寸			制品尺寸 Dφ	焊盘尺寸		
	G	Y	X		G	Y	X
4	1.0	2.6	1.6	10	4.0	4.0	2.5
5	1.4	3.0		12.5	4.0	6.0	3.2
6.3	1.9	3.5		16	6.0	7.0	
8φ×6.5L	2.1	4.0		18	6.0	8.0	
8	3.0	3.5	2.5				

● 焊接方法之适用性

焊接方法	回流焊	烙铁	波峰焊
可行性	○ 可行	○ 可行	× 不可行

● 无铅回流焊使用条件



● 测试条件

制品别	非固态电容器							高分子固态电 容器		高分子固液混 合电容器			
	4 ~ 50	4 ~ 50	≧ 63	4 ~ 100	≧ 160	---	---	---	---	---	---	---	
额定电压(V)	4 ~ 50	4 ~ 50	≧ 63	4 ~ 100	≧ 160	---	---	---	---	---	---	---	
制品尺寸(φ)	4 ~ 6.3φ × 4.5L	4 ~ 6.3	4 ~ 6.3	8 ~ 18	≧ 12.5	---	---	---	---	---	---	---	
预热	温度 (T1 ~ T2, °C)	150 ~ 180							150 ~ 200		150 ~ 180		
	时间(t1) (最大, 秒)	120	100					180		120			
持续时间	温度 (T3, °C)	230	217	230	217	217	230	217	217	230	200	217	230
	时间(t2) (最大, 秒)	t2c	t2b	t2c	t2b	t2b	t2c	t2b	t2b	t2c	t2a	t2b	t2c
最高温度	温度 (T4, °C)	250	260*		250	250		240	250	260	250	260	
	时间(t3, 秒)	5							5		5		
回流次数	1	≧ 2					2	1	2	1			

- * 如使用条件较上表所列为高时, 请与我们联系。
- * 在执行第 2 次回流焊时, 请确认电容器之温度已冷却至 5 ~ 35°C。
- * 如回流焊条件依循 IPC / JEDEC(J-STD-020), 请与我们联系。

● OP-CAP 回流焊注意事项

回流焊会降低制品额定静电容量, 应确认回流焊条件是否满足建议回流焊之规范。

虽然实际的回流焊条件变更仍依据回各项回流焊焊接方法, 请注意制品铝壳底部之最高温度及电极端子不可超过最高温度。

请特别注意: OP-CAP 制品在回流焊加热过程之温度应提高至 200°C 以上。

若回流焊条件(温度或持续时间)大于上表所列, 则 OP-CAP 制品会受损: 制品静电容量降低约 50%、漏电流变大(上升至数毫安/mA), 以及损坏电容器外部。

(1) 方法如下

回流焊:

于焊接时请遵循使用之温度条件。如使用较高之温度时, 请量测并告知电容温度及回流焊条件。

制品尺寸较大其上升的温度较缓慢。并非得依制品尺寸别调整回流焊锡炉的温度, 例如: φ4 与 φ10 制品皆会安装于 PCB 过锡炉。

(2) 焊锡注意事项

- 回流焊接温度的相关因素:
 - * 制品尺寸: 制品尺寸较大其温度上升较缓慢。
 - * 制品安装位置: PCB 中心的温度较 PCB 边缘温度低
 - * PCB 尺寸: PCB 尺寸或者厚度较厚上升的温度较慢
- 反复回流焊
 - * 如果可以, 避免回流焊 2 次。
 - * 如果反复回流是不可避免的, 请量测并告知第一次与第二次的回流温度, 以及回流焊之时间。
 - * 请勿 3 次回流焊。
- 以烙铁焊锡时请依循下列条件作业:
 - * 烙铁最高温度: 350 ± 5°C
 - * 焊接时间: 3 + 1 / - 0 秒